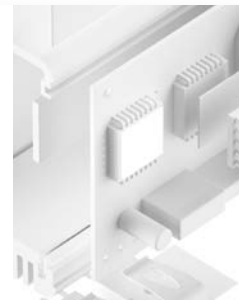


SILIKONFREIE WÄRMELEITPASTE TGR-J-NS HALA

hoch thermisch leitfähig

TGR-J-NS ist eine thermisch leitfähige Paste auf der Basis einer silikonfreien Matrix aus Esteröl. Mit ihr lassen sich sehr gute und hochzuverlässige thermische Anbindungen elektronischer Bauelemente erreichen. Durch die Formulierung und Füllung des Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine hohe thermische Leitfähigkeit. Durch ihren Einsatz werden der thermische Kontakt- und Gesamtübergangswiderstand minimiert.



Stand 09 / 2026

EIGENSCHAFTEN

- ☐ Wärmeleitfähigkeit: 2,0 W/mK
- ☐ Silikonfrei
- ☐ Dispensierbar
- ☐ Fast drucklose Aufbringung
- ☐ Dielektrisch durchschlagsfest
- ☐ Betriebstemperaturbereich: -40 bis +150°C

LIEFERFORMEN

- ☐ Kartusche 70 ml
- ☐ Dose 1 kg

ANWENDUNGSBEISPIELE

Thermische Anbindung von z.B.

- ☐ LED Boards
 - ☐ Leistungsmodulen
 - ☐ RDRAM Speicherbausteine
 - ☐ Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
- z.B. in Automotiveanwendungen / Leistungselektronik / Lichttechnik / Industriecomputer

EIGENSCHAFT	EINHEIT	TGR-J-NS
MATERIAL		
Farbe		Weiss
Dichte	g / cm ³	3,1
Viskosität (Brookfield @ 10 rpm, 25 °C)	Pas	170
RoHS Konformität	2015 / 863 / EU	Ja
THERMISCH		
Thermische Leitfähigkeit	W/mK	2,0
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 150
Lagertemperatur	°C	< 35 °C
Haltbarkeit (ab Herstelldatum, ungeöffnet)	Monate @ RT	12
ELEKTRISCH		
Durchschlagsfestigkeit	kV / mm	5,0

Typische, unverbindliche Richtwerte. Nicht für Spezifikationszwecke geeignet. Technische Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

